

Device-specific H3

Model	H311	H322
温度レンジ	600–1100°C 1000–2000°C 650–1300°C 1100–2200°C 750–1400°C 1300–2500°C 900–1800°C 1600–3300°C *)	350–800°C 800–2000°C 400–1200°C 1000–2500°C 500–1300°C 1300–3000°C **)
スペクトルレンジ	Channel 1: 0.93–1.1 μm / channel 2: 0.75–0.93 μm *) Channel 1: 0.99 μm / channel 2: 0.78 μm	Channel 1: 1.65–1.8 μm / channel 2: 1.45–1.65 μm **) Channel 1: 1.64 μm / channel 2: 1.4 μm
検出器	2 x Silicon	2 x InGaAs
応答時間 t ₉₀	< 80 μs, 最大10秒まで調整可能	
露出時間	< 40 μs	
不確実性 (ε = 1, t ₉₀ = 1s, T _A = 23°C)	読み取り値の0.5%°C	
再現性 (ε = 1, t ₉₀ = 1s, T _A = 23°C)	読み取り値の0.2%°C+1K	
シリアルインターフェース	RS485 (最大921.6kBd) 分解能 0.1°C	
光学系(オプション)	マニュアルフォーカシング可能な光学系(内蔵または光ファイバー仕様)	
消費電力	max. 12 VA (all outputs unconnected) すべての出力が未接続状態	
周囲温度	0~60°C, 光ファイバーおよび光学系側のオプティクス:-20~250°C (過熱防止のため、デバイスの温度が60°C以上になると、照準用レーザー光は停止します)	